

Datenblatt

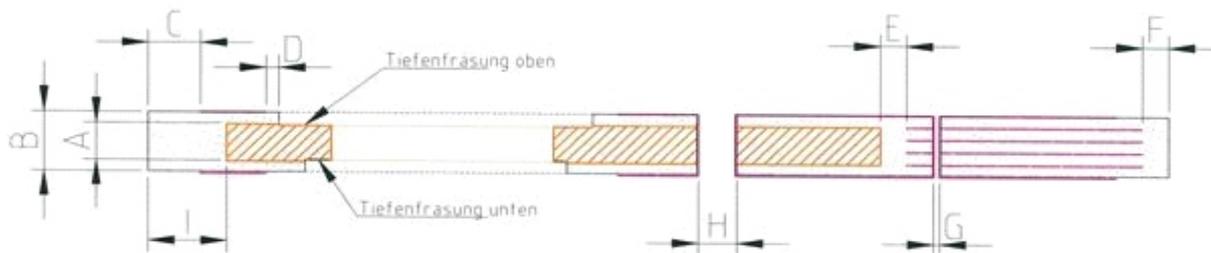
Hochstrom-Leiterplatten

LFG - Eckhard Oertel e.K. • GP Keplerstraße 35 • 07549 Gera



Layout	Strukturbreite	150 µm
	Strukturabstand	150 µm
	umlaufende Löstopplack-Freistellung	50 µm
	kleinster Löstopplack-Steg	150 µm
	kleinste Restringe	150 µm
	kleinster Fräsradius	500 µm
	kleinster Ritzwinkel	30 °
Oberfläche	chem. Zinn, chem. Ni/Au , chem. Ag	
	Hartgold, Bondgold	
	Carbondruck	
Löstopplack	grün / schwarz / blau / rot ...	
	superweiß (für LED- Anwendungen)	
	abziehbare Lötdeckmaske Kaptonband	
Kennzeichendruck	weiß / gelb / schwarz ...	
Qualitätskontrolle	optische Kontrolle	
	AOI, elektrischer Test	
	Erstmusterprüfung	
Daten	vorzugsweise Gerberdaten	
	Eagle, TARGET, PROTEL, Altium, etc.	
Zertifikate / Normen	ISO 9001:2015	
	IPC-A-600	
andere Materialien und Ausführungen auf Anfrage		

Desian-Rules Hochstrom



A	Dicke Cu-Inlay	1,0; 1,5; 2,0 mm
B	Dicke LP	abhängig von Cu-Inlay (mind. 1,5 mm)
C	Abstand Layout zur Kante	0,5 mm
D	Abstand Layout zur Fräsung	0,5 mm
E	Abstand Layout zu Cu-Inlay	1,0 mm
F	Abstand Layout Innenlagen zur Kante	0,5 mm
G	kleinste Bohrung Layout	abhängig von Dicke LP (mind. 0,3 mm)
H	kleinste Bohrung Cu-Inlay	mind. Dicke des Cu-Inlay
I	Abstand Cu-Inlay zur Kante	kann bis an die Kante oder darüber hinaus

für Anbindungen an das Cu-Inlay sind auch "Blind Vias" möglich

LEITERPLATTEN-EILDIENTST FLACHBAUGRUPPEN MECHANISCHE UND ELEKTRONISCHE GERÄTE INGENIEURBÜRO-SERVICE

E-Mail info@lfg-oertel.de
Web www.lfg-oertel.de
Telefon 0365 / 773 209 - 0
Fax 0365 / 773 209 - 20

Commerzbank AG Jena
Deutsche Bank AG Gera
Sparkasse Gera - Greiz
Oberbank AG Jena

IBAN DE86 8304 0000 0215 5000 00
IBAN DE75 8207 0024 0319 0246 00
IBAN DE20 8305 0000 0000 0564 72
IBAN DE59 7012 0700 1691 1001 17

BIC COBA DE FF 830
BIC DEUT DE DBERF
BIC HELA DE F1GER
BIC OBKL DE MX

HRA 503221
Ust-ID DE 1505 90006
St.-Nr. 161 254 02996